

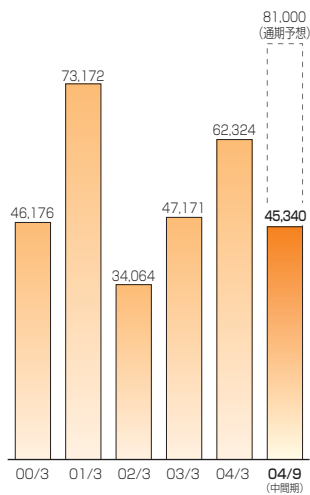
A large, dynamic white brushstroke graphic that forms an irregular oval shape, framing the central text.

ACCRETECH

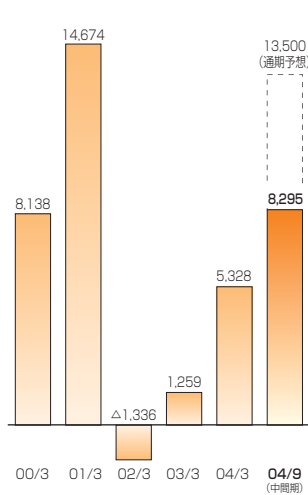
第82期 中間事業報告書

株式会社東京精密

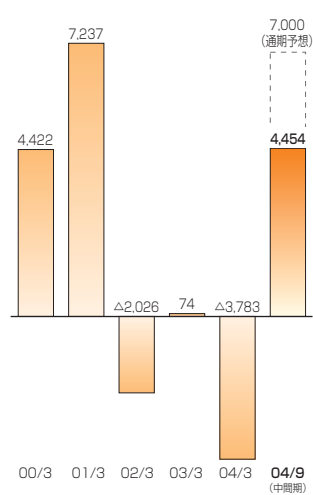
連結売上高
(百万円)



連結経常利益
(百万円)



連結当期純利益
(百万円)



単位:百万円

	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	2004/3	2004/9 (中間期)
連結売上高	46,176	73,172	34,064	47,171	62,324	45,340
連結経常利益	8,138	14,674	△1,336	1,259	5,328	8,295
連結当期純利益	4,422	7,237	△2,026	74	△3,783	4,454
連結総資産	61,007	91,477	79,865	88,669	94,893	98,311
株主資本	33,433	38,779	35,423	33,645	29,183	33,530
発行済株式総数 (千株)	37,542	37,465	37,370	37,355	37,354	37,497
1株当たり連結当期純利益 (円)	118.43	192.95	△54.21	1.64	△101.67	119.07

※ 1株当たり連結当期純利益は、期中の平均株式数により算出しています。

※ 発行済株式総数は、自己株式を除いた数字です。

見通しに関する注意事項

この事業報告書に掲載されている東京精密の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実ではない事柄は、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。リスクや不確実性には、世界経済の動向、当社の事業領域の市況、為替変動、急速な技術革新による競争の激化などがあります。このような事象により、実際の業績はこれら見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。



東京精密の株式を保有していただき、有難う存じます。厚く御礼申し上げます。

さて、当社は、株主の皆様が当社株式を保有していただいた目的に沿った経営を目指しております。

経営指標といたしましては、1株当たりの純利益（EPS）を長期的に増大させていくことを重視しております。これは当社が非常に重要と考えている「WIN-WIN」の関係を株主の皆様と会社との間で作り上げることに繋がると確信しております。

当社は、技術指向型の会社です。上記の目的のために当社の経営の大原則である「製品開発の原則」に沿って技術開発を継続的に行っています。

また当社は、「世界No.1の製品を創る」という目的を共有できる企業および人材と積極的にパートナーシップを結び、ナノテクノロジー

製品開発の原則

1. 世界No.1の製品を創る。
マーケットシェアNo.1の商品は
(1) 好況時の利益の極大化がはかれる。
(2) 不況時の損失の極小化がはかれる。
2. 研究開発投資は自己資金で。
3. 開発は技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う。
4. 相応しいパートナーを見つけ、開発コストをシェアするとともに開発の成果を共有する。

レベルの画期的な製品開発を実現しています。協業を成功させるために、「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」というモットーのもと、異文化を包摂したグローバルかつハイブリッドな東京精密の文化風土を醸成し、世界No.1の商品開発体制の構築に努めております。

さらに、2001年1月には「ACCRETECH（アクレーテック）」というコーポレートブランドを導入しました。「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長していく」という当社の企業理念を表したものです。

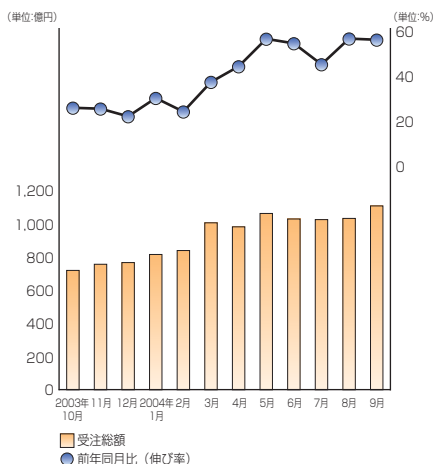
株主の皆様にも是非当社の企業理念にご賛同賜り、このコーポレートブランド「ACCRETECH」のもと、さらなる飛躍を目指す当社に、今後とも格別なるご理解とご支援をお願い申し上げます。

代表取締役会長C.E.O.

大坪英夫



最近1年間の工作機械受注統計



出所：(社)日本工作機械工業会

Question-1

半導体製造装置市場の今後の見通しを教えてください。

半導体製造装置市場は、昨年後半より急回復し、当社の受注高も2004年度第1四半期の過去最高記録を含め、3四半期連続して過去最高レベルで推移しました。その後、8月中旬から調整局面に入り、この状況が少なくとも今年一杯続くと予想されています。しかし、今回の下降局面の底は浅く、比較的短いといわれています。

中期的には、半導体製造装置市場は成長市場です。前回の好況期までは、パソコンや携帯電話向けが主な需要でしたが、半導体使用製品の裾野が拡大し、ますます高機能化する携帯電話をはじめとするデジタルコンシューマー機器が、今後の市場を牽引していくと考えられています。現在は、まさにその移行期にあり、デジタルコンシューマー機器の普及に合わせて、今後10年間程度はアジアを中心に高水準の半導体関連投資が継続され、拡大基調が加速することが予想されています。

当社は、半導体製造プロセスの中でも成長力の高い分野に経営資源を集中させ、成長企業として、さらなる発展を目指しています。

Question-2

計測機器市場の今後の見通しを教えてください。

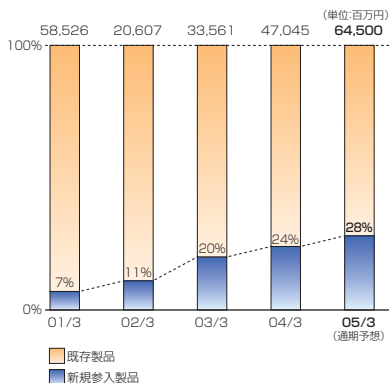
今期は国内景気の好調さを背景に計測機器需要が活発化しており、汎用計測製品と自動計測製品のいずれにおいても、需要拡大が見込まれています。

主な需要先である自動車および自動車部品業界では設備投資が拡大しております。加えて、ベアリングや工作機械、デジタルコンシューマー機器やハードディスク業界も好調です。環境性能アップ、小型化・高機能化などのために、より高精度な計測機器に対するニーズが拡大しています。

当社の現在の主要市場は日本ですが、今後は中国やインドを含むアジア地域を中心とした海外のシェア拡大にも注力していきます。また、当社の独自技術を駆使して新製品を投入した光通信関連市場のように、成長が見込まれる新しい分野への参入にも注力し、さらなる売上拡大を図ります。

計測機器市場は成熟市場である一方、お客様からの要求はますます厳しくなっています。当社は今後も引き続きコストダウンなどに注力し、営業利益率20%以上を確保していきます。

新規参入製品と既存製品の売上比率



八王子新工場 (完成予想図)



土浦新工場 (完成予想図)



Question-3

御社の新規参入製品は今後の成長が期待できると聞きました。新規参入製品の状況を教えてください。

当社は、変化の激しい半導体業界では、成長分野への積極的な投資と参入が必要と考えます。したがって「製品開発の原則」(参照:P1右上)の3番「開発は技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う」に則って積極的に投資を行い、プロービングマシンとダイシングマシンという主力製品に加え、2000年にウェーハ外觀検査装置とポリッシュ・グラインダ、2002年にCMPを市場投入し、毎年順調に売上高を伸ばしています。4つめの新規参入製品であるリソグラフィ装置「LEEPL」は、現在お客様による評価中です。

ポリッシュ・グラインダは、加速する薄片化に対応する装置としてデファクトスタンダード(業界標準)の立場を確立しました。また、CMPについても、その性能に対するユーザーの評価が高く、さらなるビジネスの拡大が見込まれています。2000年度の半導体製造装置部門の売上高に占める上記新規参入製品の割合は7%でしたが、2003年度には24%まで拡大し、今年度は28%に達すると見込まれています。

Question-4

八王子と土浦に新工場を建設することを決定されましたが、今後の事業拡大を見越しての先行投資と考えていいのでしょうか。

現在、約30億円の予算で、半導体社の新工場を八王子に、計測社の新工場を土浦に建設中です。両工場とも2005年3月の竣工を予定しています。

半導体製造装置の中でも、ポリッシュ・グラインダやCMPの売上が好調であり、生産スペースの拡大が急務となっています。加えて、ダイシングマシンにおいてもシェアが伸長しており、生産台数が増加しています。これに対応するため、現在の八王子工場の隣接地に工場を新設し、ポリッシュ・グラインダ、CMPおよびダイシングマシンの生産能力を拡大します。特にCMPは2005年度から事業の一層の拡大を見込んでいます。

一方、計測ビジネスにおいても、国内景気の回復にとまぬい、自動車や工作機械、ベアリング、金型メーカーなどからの当社計測機器へのニーズの増加に対応するため、土浦工場内に新工場を建設し、生産能力を強化します。同時に、生産工程や工場全体の機能の見直しを行い、より機動性の高い効率的な生産システムの実現をはかります。

Question-5

2004年度中間期の業績を教えてください。

2004年度中間期の連結売上高は453億40百万円(前年同期比75%増)、連結営業利益は81億58百万円(同17.2倍)、連結経常利益は82億97百万円(同8.3倍)、連結当期純利益は44億54百万円(同6.1倍)となり、半期業績としては過去最高の売上と利益を達成しました。

【半導体製造装置部門】

カメラ付き携帯電話やデジタルカメラ、薄型テレビ、DVDプレーヤーなどのデジタルコンシューマー機器の好調、堅調なパソコン需要を反映し、国内外の半導体メーカーの設備投資は、昨年後半から引き続き旺盛に推移しました。その結果、中間期の売上高は366億91百万円(前年同期比97.6%増)と半期の売上高として既往ピークを更新しました。地域別では、日本や韓国、台湾および北米が好調で、前年比大幅に伸長しました。中国も着実に売上が拡大しており、今後が期待されます。利益面では、売上の増加の一方で、内製比率のアップによる変動比率の引き下げや固定費増の圧縮などコストダウン施策を展開した結果、61億92百万円の営業利益を計上し、大幅な改善となりました。上期の受注高は384億88百万円となり、半期受注高として既往ピークを更新しました。

【計測機器部門】

国内の景気が上向く中、当社の計測機器の主なユーザーである自動車や工作機械、ベアリング業界などの設備投資が活発で、国内外とも売上を伸ばし、売上高は86億49百万円(前年同期比17.8%増)となりました。また、生産面でもコストダウンに注力し、営業利益も19億64百万円(同32.5%増)と増益を達成しました。

Question-6

2004年度通期の見通しを教えてください。

今下期の連結売上高は357億円を予定しており、2004年度通期では連結売上高は810億円(前年同期比30%増)、連結営業利益は135億円(同2.3倍)、連結経常利益は135億円(同2.5倍)、連結当期純利益は70億円と予想しています。

【半導体製造装置部門】

今下期の半導体市場は、8月中旬から調整局面に入り、少なくとも年内は引き続き調整局面が継続すると見込まれます。したがって、マーケットシェアの高いブローピングマシンやダイシングマシンなどの既存製品の売上高の減少は避けられないと考えていますが、ウェーハ外観検査装置やポリッシュ・グラインダ、CMPの新規参入製品は、ユーザーからの高い評価を得て、マーケットシェアを拡大中であり、上期比着実な売上増を予想しています。その結果、半導体製造装置の2004年度下期の売上高は278億円、通期では過去最高の645億円(前年同期比37.1%増)と予想しています。

【計測機器部門】

計測機器部門は、引き続き堅調な需要が見込まれ、今下期の売上高は79億円、通期では165億円(前年同期比7.9%増)を予定しています。

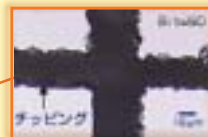
ダイシングマシンに画期的な技術が登場!! 半導体薄片化のニーズをとらえたMAHOHDICING MACHINE、 ついにリリース!!

ブレード(刃)の代わりにレーザーでウェーハを分割する新製品「MAHOHDICING MACHINE」が当社のダイシングマシンのラインナップに加わりました。このダイシングマシンは、浜松ホトニクス株式会社が開発した画期的な新型レーザーを搭載しており、携帯電話やSDカード、IC搭載カードなど、昨今の半導体に求められている薄片化のニーズに的確に対応しています。ブレードを使う従来製品と異なる大きな特長をクローズアップしました。

特長1 世界一きれいに切ります!!

新型レーザーでは、右の写真のようにとてもきれい(=欠けがない)に無駄なくウェーハをチップに分割できます。欠けがないことによりチップの強度が向上し、その後のチップの割れや不具合の発生を低減します。これは、現在の主流であるブレード(刃)ダイサや従来型レーザーを搭載した熱で切るレーザーダイサでは避けられない問題でしたが、MAHOHDICING MACHINEが世界で初めて解決しました。

ブレードダイサで切った切断結果



切り口はガタガタで、無駄になる面積も大きい

MAHOHDICING MACHINEで分割した切断結果



一本の線のように、きれいに切られています!

特長2 水を使いません!!

これまでのダイシングマシンでは、切粉の洗浄・摩擦熱の冷却などのため、必ず水(純水)を使用していました。しかし、新型レーザーを使用するMAHOHDICING MACHINEは、こうした水の使用、ひいては廃水処理の必要がなくなり、環境にもやさしい製品といえます。

特長3 「切りしろ」がゼロ!!

従来は、ブレードの厚さ分以上の「切りしろ」が必ず発生してしまいましたが、新型レーザーではこの切りしろがゼロです。これは1枚のウェーハから製造される半導体チップ数の増加を意味するだけでなく、ブレードや従来式レーザーのように、切断の際に削られた微細な「かけら」が他のチップ上に飛び散って発生する不良の原因になることもありません。

特長4 とにかく速いです!!

この装置は300mm/秒の切断速度により、今後ますますニーズが高まる薄型ウェーハにおいて、ブレードダイシングと比べて4倍以上の生産性を実現します。



中間連結貸借対照表

単位:千円

科目	前連結会計年度末 (04.03.31)	当中間連結会計期間末 (04.09.30)
流動資産	70,944,939	75,001,840
固定資産	23,948,312	23,309,232
有形固定資産	12,847,694	12,600,194
無形固定資産	3,756,991	3,146,777
投資その他の資産	7,343,626	7,562,261
繰延資産	61	45
資産合計	94,893,313	98,311,118

単位:千円

科目	前連結会計年度末 (04.03.31)	当中間連結会計期間末 (04.09.30)
流動負債	33,285,651	34,014,454
固定負債	30,301,641	28,466,267
負債合計	63,587,293	62,480,721
少数株主持分	2,122,589	2,299,906
資本		
資本金	7,199,991	7,392,064
資本剰余金	11,806,740	12,017,854
利益剰余金	10,273,770	14,153,705
その他有価証券評価差額金	57,783	41,585
為替換算調整勘定	△105,115	△16,460
自己株式	△49,739	△58,259
資本合計	29,183,430	33,530,490
負債、少数株主持分及び資本合計	94,893,313	98,311,118

中間連結損益計算書

単位:千円

科目	前中間連結会計期間 (03.04.01~03.09.30)	当中間連結会計期間 (04.04.01~04.09.30)
売上高	25,909,055	45,340,895
売上原価	19,910,762	30,847,033
売上総利益	5,998,292	14,493,862
販売費及び一般管理費	4,652,518	6,336,075
営業利益	1,345,773	8,157,787
営業外収益	94,152	323,776
営業外費用	438,684	185,785
経常利益	1,001,242	8,295,778
特別利益	198,305	184,047
特別損失	205,477	583,910
税金等調整前中間純利益	994,070	7,895,916
法人税、住民税及び事業税	372,257	1,207,381
法人税等調整額	264,338	2,001,354
少数株主利益	98,460	232,873
中間純利益	259,014	4,454,306

中間連結剰余金計算書

単位:千円

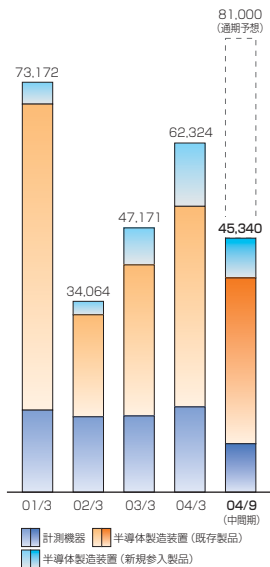
科目	前中間連結会計期間 (03.04.01~03.09.30)	当中間連結会計期間 (04.04.01~04.09.30)
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	11,806,740	11,806,740
資本剰余金増加高		
新株引受権の権利行使 による増加高	-	211,113
資本剰余金減少高	-	-
資本剰余金中間期末残高	11,806,740	12,017,854
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	15,191,079	10,273,770
利益剰余金増加高	259,014	4,454,306
中間純利益	259,014	4,454,306
利益剰余金減少高	573,172	574,371
配当金	560,338	560,322
取締役賞与金	12,834	14,049
利益剰余金中間期末残高	14,876,921	14,153,705

中間連結キャッシュ・フロー計算書

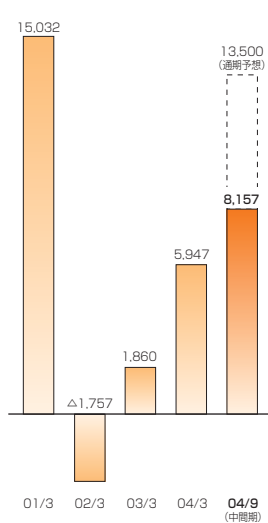
単位:千円

科目	前中間連結会計期間 (03.04.01~03.09.30)	当中間連結会計期間 (04.04.01~04.09.30)
営業活動によるキャッシュ・フロー	970,919	5,554,475
投資活動によるキャッシュ・フロー	△923,798	△857,687
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,145,778	△6,847,734
現金及び現金同等物に係る換算差額	△10,168	58,702
現金及び現金同等物の増減額	1,182,730	△2,092,243
現金及び現金同等物の期首残高	6,193,841	12,242,121
現金及び現金同等物期末残高	7,376,572	10,149,877

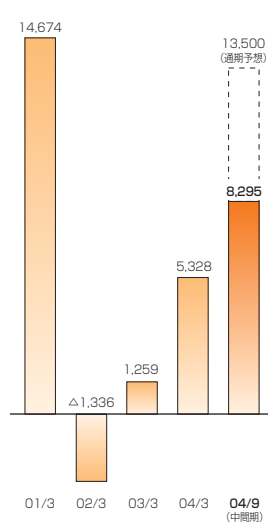
売上高内容構成 (百万円)



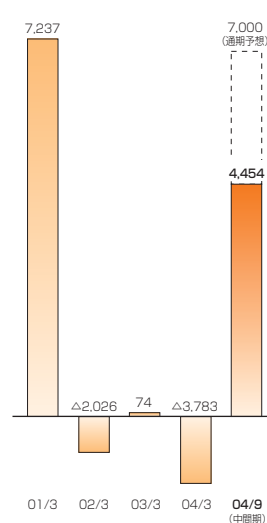
営業利益 (百万円)



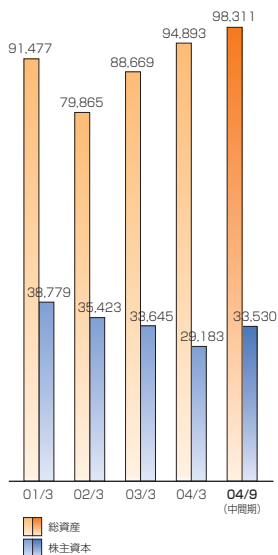
経常利益 (百万円)



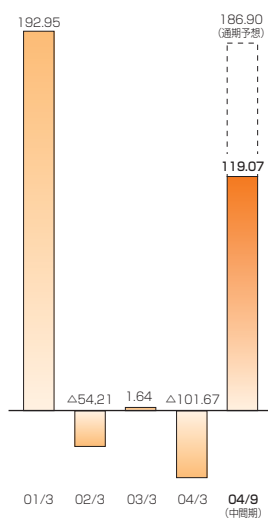
当期純利益 (百万円)



総資産 / 株主資本 (百万円)



1株当たり当期純利益(EPS) (円)



主要財務指標(連結)

経営指標		03/9 (中間期)	傾向	04/9 (中間期)
営業利益率	%	5.2	↗	18.0
経常利益率	%	3.9	↗	18.3
当期純利益率	%	1.0	↗	9.8
株主資本当期純利益率(ROE)	%	0.8	↗	14.2
使用総資本当期純利益率(ROA)	%	0.3	↗	4.6
使用総資本回転率	回	0.3	↗	0.5
連結従業員数	人	1,096	↗	1,132
従業員一人当たり売上高	千円	23,586	↗	40,628
従業員一人当たり経常利益	千円	911	↗	7,433
従業員一人当たり当期純利益	千円	236	↗	3,991
1株当たり当期純利益(EPS)	円	6.93	↗	119.07
株価収益率(PER)	倍	489.2	↘	26.0
当座比率	%	63.2	↗	118.9
流動比率	%	150.9	↗	220.5
固定比率	%	88.6	↘	69.5
固定長期適合率	%	61.7	↘	37.6
負債比率	%	162.8	↗	186.3
自己資本比率	%	37.2	↘	34.1

中間貸借対照表(個別決算)

単位:千円

科目	前会計年度末 (04.03.31)	当中間会計期間末 (04.09.30)
流動資産	64,857,606	66,957,349
固定資産	22,527,101	21,963,359
有形固定資産	7,488,036	7,506,621
無形固定資産	3,209,474	2,683,470
投資その他の資産	11,829,590	11,773,267
資産合計	87,384,707	88,920,709

単位:千円

科目	前会計年度末 (04.03.31)	当中間会計期間末 (04.09.30)
流動負債	31,389,217	31,343,848
固定負債	26,791,505	24,813,811
負債合計	58,180,723	56,157,659
資本		
資本金	7,199,991	7,392,064
資本剰余金	11,806,740	12,017,854
利益剰余金	10,191,938	13,371,336
その他有価証券評価差額金	55,053	40,053
自己株式	△49,739	△58,259
資本合計	29,203,984	32,763,049
負債及び資本合計	87,384,707	88,920,709

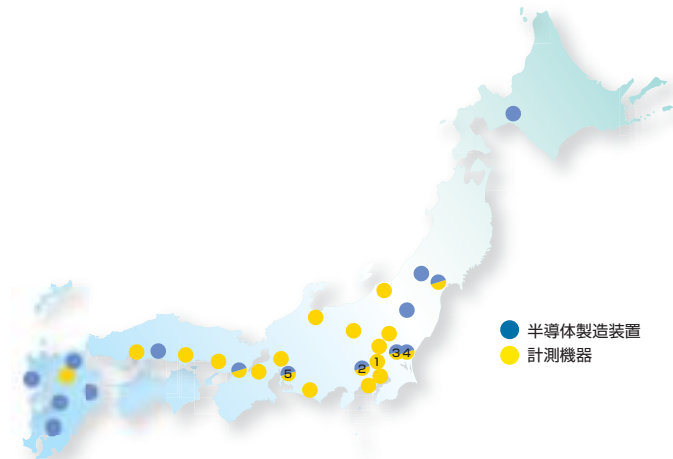
中間損益計算書(個別決算)

単位:千円

科目	前中間会計期間 (03.04.01~03.09.30)	当中間会計期間 (04.04.01~04.09.30)
売上高	23,104,980	39,505,823
売上原価	19,401,918	28,910,736
売上総利益	3,703,061	10,595,086
販売費及び一般管理費	2,952,015	4,319,651
営業利益	751,045	6,275,434
営業外収益	347,924	440,275
営業外費用	449,651	159,482
経常利益	649,318	6,556,227
特別利益	198,305	184,047
特別損失	205,477	583,910
税引前中間純利益	642,146	6,156,364
法人税、住民税及び事業税	19,866	615,204
法人税等調整額	190,206	1,801,440
中間純利益	432,073	3,739,720
前期繰越利益	8,615,695	3,903,061
中間未処分益	9,047,768	7,642,781

当社は、成長分野において、最先端技術を駆使した世界No.1商品を提供することにより、企業価値を高め、株主の皆様へ利益還元をはかりたいと考えています。将来の事業展開のための企業体質強化に配慮の上、株主の皆様の長期的視点を重視した安定的な配当を実施していきます。

国内主要拠点



1 本社（業務会社）



2 八王子工場（半導体社）
株式会社アクレーテック・マイクロテクノロジー



3 土浦工場（計測社）



4 株式会社 東精エンジニアリング
本社・工場



5 株式会社 東精エンジニアリング
名古屋工場

海外拠点



● 半導体製造装置
● 計測機器



6 Accretech USA, Inc.



7 Accretech
(Europe) GmbH



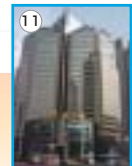
8 Accretech
(Israel) Ltd.



9 Accretech
(Malaysia) Sdn. Bhd.



10 Accretech
(Singapore) Pte. Ltd.



11 Accretech
(China) Co., Ltd.

今回の中間事業報告書より、当社の製品が社会のどのような場面で活躍しているかをご紹介します。というと思います。

当社は、半世紀以上も前から「測れないものはない」という考えを基本に、精密測定機器を製造しています。現在、私たちが毎日使うさまざまな製品は、全てその設計・製造・検査などの段階で「計測」されることにより、安全性・安定性・環境性・デザイン性などをチェックされています。

当社の礎である計測製品は社会の礎でもあり、これからもより高精度な製品を提供し続けていくことで、「安全・便利でありながらも地球への負担をできるだけ減らしたものづくり」を支えていきます。

計測機器の中心的ユーザーである自動車業界は、「高性能」で「環境にやさしい」自動車をいかに「低コスト」で製造し提供できるかという大きな課題に挑戦し続けています。そこで「社会を支えるアクレーテクの技術」第一回は、自動車の製造工程において、当社の製品がどのように活躍しているかをご紹介します。

真円度・円筒形状測定機

【なにを測るの?】

燃料噴射装置の噴射ノズルやエンジンのピストンなど

【どうして?】

燃費の向上やエンジンの出力アップを実現するためには、噴射ノズルの円形が高精度であることが要求されるため、その精度を測定します。



表面粗さ・輪郭形状測定機

【なにを測るの?】

クランクシャフトやカムシャフトなどのエンジン内部の部品

【どうして?】

自動車からの二酸化炭素排出量や有害排出ガスの発生を抑えるために、適切な凹凸を測定し、回転ロスを低減します。





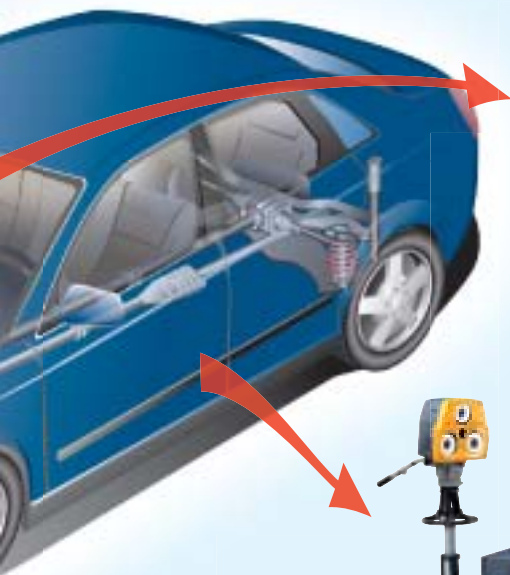
マシンコントロールゲージ

【なにを測るの?】

エンジン、トランスミッションなどに使われる精密加工部品

【どうして?】

量産ライン上を流れていく部品の寸法、形状を全数測定し、常に良品だけが生産されるように加工機をコントロールします。高効率で安定した生産ラインの構築には不可欠な測定システムです。



三次元座標測定機

【なにを測るの?】

シリンダブロックやシリンダヘッドなど

【どうして?】

静かなエンジン音や低燃費を実現するために、今後ますます高精度が求められるシリンダブロックなどは非常に複雑な形状をしており、その精度の測定は三次元座標測定機が可能にします。



3Dヴィジョンシステム

【なにを測るの?】

ボディなど

【どうして?】

撮影した画像データから三次元形状のデータを取り込み、測定することを可能としたため、ボディなどの大型部品の測定にかかる時間の大幅な短縮や治具コストの削減を実現しました。

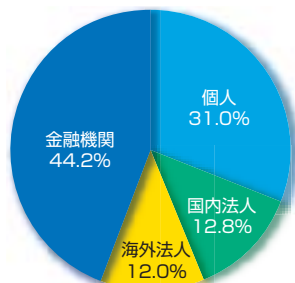
商号	株式会社 東京精密 (TOKYO SEIMITSU CO., LTD.)	
設立	昭和24年3月28日	
資本金	7,392,064,755円	
証券取引所	東京証券取引所 市場第一部	
会社が発行する株式の総数	110,501,100株	
発行済株式の総数	37,497,268株	
株主数	25,284名	
役員 <small>(平成16年11月30日現在)</small>	代表取締役会長C.E.O.	大坪 英夫
	代表取締役社長C.O.O. 半導体社担当	鈴木 貞勝
	代表取締役E.V.P. 計測社担当	藤森 一雄
	代表取締役E.V.P. 海外担当	長澤 英二
	代表取締役E.V.P.兼C.F.O. 業務会社担当	太田 邦正
	取締役	西嶋 尚生
	取締役グループC.I.O.	梅中 茂
	取締役	高城 英明
	取締役	ウォルフガング ボナッツ
	取締役	グレッグ セバスチャン
	監査役(常勤)	吉儀 肇
	監査役	輕部 昭三郎
	監査役	小倉 利之
	監査役	山本 清次
従業員数	642名(単体) 1,132名(連結)	
主要取引銀行	みずほコーポレート銀行	大手町営業部
	三井住友銀行	本店
	りそな銀行	吉祥寺支店
	東京三菱銀行	新宿中央支社
	常陽銀行	土浦支店
	関東つくば銀行	本店

事業所	業務会社	東京都三鷹市
	半導体社	東京都八王子市
	計測社	茨城県土浦市
営業所	東北(宮城県仙台市)	長野(長野県岡谷市)
	○山形(山形県山形市)	浜松(静岡県浜松市)
	茨城(茨城県土浦市)	名古屋(愛知県三好町)
	宇都宮(栃木県宇都宮市)	小牧(愛知県西春町)
	埼玉(埼玉県さいたま市)	京滋(滋賀県守山市)
	東京(東京都三鷹市)	◎大阪(大阪府吹田市)
	○東京(東京都八王子市)	加古川(兵庫県加古川市)
	西東京(東京都八王子市)	岡山(岡山県岡山市)
	川崎(神奈川県川崎市)	広島(広島県広島市)
	新潟(新潟県分水町)	九州(福岡県久留米市)
	厚木(神奈川県厚木市)	○九州(大分県大分市)
	北陸(富山県富山市)	
	(注)◎:全製品取扱 ○:半導体製品取扱 無印:計測製品取扱	

株式の状況

株主名	大株主	
	持株数(千株)	出資比率(%)
日本マスタートラスト		
信託銀行株式会社(信託口)	5,956	15.9
野村信託銀行株式会社(投信口)	2,277	6.1
日本トラスティ・サービス		
信託銀行株式会社(信託口)	1,719	4.6
日本精工株式会社	1,113	3.0
財団法人精密測定技術振興財団	1,058	2.8
三井生命保険株式会社	900	2.4
株式会社みずほコーポレート銀行	800	2.1
株式会社損害保険ジャパン	600	1.6
高城ヒデ子	580	1.5
第一生命保険相互会社	542	1.4

所有者別状況(株式数比率)



株主メモ

決算期	毎年3月31日
定時株主総会	毎年6月中 基準日毎年3月31日 その他必要あるときは、あらかじめ基準日を公告いたします。
名義書換代理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱所	〒135-8722 東京都江東区佐賀一丁目17番7号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話(03)5213-5213(代表)
同取次所	みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
株式取扱手数料	みずほインベスターズ証券株式会社 全国各支店 名義書換 無料 新株券交付 無料
公告掲載新聞	東京都において発行される日本経済新聞 (ただし、決算公告につきましては当社のホームページに掲載しております。)



キリトリ線

郵便はがき

1 8 1 - 8 7 9 0

料金受取人払

三鷹局承認

578

差出有効期限
平成17年3月
31日まで

東京都三鷹市下連雀9-7-1

株式会社 東京精密
業務会社 総務室 宛



【お知らせ】

○株式事務に関する名義書換代理人を変更いたしました。
当社は、株式事務に関する名義書換代理人を平成16年12月1日から変更いたしました。
つきましては、当社株式の名義書換や単元未満株式の買取り、その他株式に関する事務は、左記(名義書換代理人)にて、お取扱いまたはそのお取次ぎをいたしますので、何卒ご高承賜りますようお願い申し上げます。

IRメール配信中!

方法1

ホームページトップからアクセス!
「IR配信メールのご登録はこちら」または
「投資家の皆様へ」をクリック!



方法2

「投資家の皆様へ」トップからアクセス!
「IR配信メールの登録はこちら」の
バナーをクリック!



決算発表や主要ニュースリリースの
ご案内をお送りします。
是非ご登録ください。

TOKYO SEIMITSU
<http://www.accretech.jp>